

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 12 月 19 日(19.12.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/187303 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08J 5/24 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C08K 3/34 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/065678
- (22) 国際出願日: 2013 年 6 月 6 日(06.06.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-132685 2012 年 6 月 12 日(12.06.2012) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小林 裕明(KOBAYASHI, Hiroaki); 〒9618031 福島県西白河郡西郷村大字米字楢山 9 番 4 1 号 MGCエレクトロテクノ株式会社内 Fukushima (JP). 十亀 政伸(SOGAME, Masanobu); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 野水 健太郎(NOMIZU, Kentaro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 馬淵 義則(MABUCHI, Yoshinori); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 加藤 禎啓(KATO, Yoshihiro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三

菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG, METAL FOIL-CLAD LAMINATE AND PRINTED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、金属箔張積層板及びプリント配線板

(57) Abstract: Provided are: a resin composition which is capable of providing a printed wiring board or the like that has excellent heat dissipation properties, water absorption, copper foil peel strength and heat resistance after moisture absorption; and a prepreg, a laminate, a metal foil-clad laminate, a printed wiring board and the like, each of which uses the resin composition. A resin composition of the present invention contains at least (A) an epoxy resin, (B) a cyanic acid ester compound and (C) an inorganic filler; and the inorganic filler (C) contains at least a surface-treated silicon carbide (C-1) that is obtained by treating at least a part of the surface of a silicon carbide powder with an inorganic oxide.

(57) 要約: 放熱性、吸水性、銅箔ピール強度、及び吸湿耐熱性に優れるプリント配線板等を実現可能な樹脂組成物、並びに、これを用いたプリプレグ、積層板、金属箔張積層板及びプリント配線板等を提供する。本発明の樹脂組成物は、エポキシ樹脂 (A)、シアン酸エステル化合物 (B) 及び無機充填材 (C) を少なくとも含有し、該無機充填材 (C) は、炭化ケイ素粉体の表面の少なくとも一部が無機酸化物で処理された表面処理炭化ケイ素 (C-1) を少なくとも含む。



WO 2013/187303 A1